

# 天津金海通半导体设备股份有限公司

## 关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、已审议通过的综合授信额度

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包括纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行等金融机构申请合计总额不超过等值人民币6亿元（含6亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、林吉特等）的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准）。上述额度在授权期限内可以循环使用，公司及下属公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另行召开董事会。具体内容详见公司于2026年1月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

### 二、本次增加综合授信额度的情况

为更好地满足公司发展规划和战略实施的需要，公司及下属公司（包括纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟在上述已审议通过的综合授信额度的基础上，增加不超过等值人民币8亿元（含8亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、林吉特等）的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准）。本次增加后，公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度合计总额不超过等值人民币14亿元（含本次新增额度，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、林吉特等）。

上述额度在授权期限内可以循环使用，公司及下属公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另行召开董事会。董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、固定资产项目贷款等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。授权期限自本次董事会审议通过之日起至2027年1月19日止。

公司及下属公司可以不动产、动产或权益向银行、担保公司等金融机构为公司

上述申请银行综合授信额度等相关事项提供担保，具体担保、反担保的金额、方式以公司与银行、担保公司等金融机构最终协商签订的担保协议为准。

### **三、审议程序**

本次增加向金融机构申请综合授信额度事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会第二十九次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议。

### **四、对公司的影响**

本次增加向金融机构申请综合授信额度事项，是为了更好地满足公司发展规划和战略实施的需要，不会对公司及下属公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026年6月24日